

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載  
【部門区分】第 1 部門第 2 区分  
【発行日】令和 7 年 6 月 2 日(2025.6.2)

【公開番号】特開 2024-109798(P2024-109798A)  
【公開日】令和 6 年 8 月 14 日(2024.8.14)  
【年通号数】公開公報(特許)2024-151  
【出願番号】特願 2024-83754(P2024-83754)  
【国際特許分類】

A 6 3 F 5/04(2006.01)

10

A 6 3 F 7/02(2006.01)

【F I】

A 6 3 F 5/04 6 0 1 B

A 6 3 F 5/04 6 0 5 B

A 6 3 F 7/02 3 2 6 Z

A 6 3 F 7/02 3 0 1 C

【手続補正書】

【提出日】令和 7 年 5 月 23 日(2025.5.23)

【手続補正 1】

20

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 5

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 5】

本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、表面実装部品を用いた基板の検査を容易に行えるようにすることを目的とする。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 0 7

30

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 0 7】

( 1 ) の遊技機は、

主制御基板(例えば、主制御基板 4 1 1)を備える遊技機であって、

前記主制御基板には、前記主制御基板の表面側でその端子が半田付けされる複数の表面実装部品と、前記主制御基板を貫通するスルーホールに前記主制御基板の表面側からその端子を挿通させ、前記主制御基板の裏面側でその端子が半田付けされる複数のディップ実装部品と、が実装され、

前記表面実装部品として、第 1 の部品(例えば、I C 3)と、第 2 の部品(例えば、I C 5)を少なくとも含み、

40

前記第 1 の部品及び前記第 2 の部品はそれぞれ複数の端子を有しており、前記第 1 の部品の複数の端子と前記第 2 の部品の複数の端子との間がそれぞれ配線で接続され、

前記第 1 の部品の複数の端子と前記第 2 の部品の複数の端子との間を接続する配線のそれぞれに対してテストポイントが設けられており、

前記主制御基板の前記表面実装部品の実装面に対して反対側となる面には前記テストポイントが設けられず、

前記配線のそれぞれに対して接続されたテストポイント同士の間隔は、前記複数の端子の間を接続する配線同士の間隔のうち最も狭い部分の間隔よりも広いものであり、

前記テストポイントは、前記主制御基板に設けられ前記ディップ実装部品が実装されない

50

貫通孔であるビアホールのサイズと異なるサイズを有する（図４４）ことを特徴とする。

【手続補正３】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】０００９

【補正方法】変更

【補正の内容】

【０００９】

上記構成の遊技機によれば、表面実装部品を用いた基板の検査を容易に行うことができる。

【手続補正４】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項１】

主制御基板を備える遊技機であって、

前記主制御基板には、前記主制御基板の表面側でその端子が半田付けされる複数の表面実装部品と、前記主制御基板を貫通するスルーホールに前記主制御基板の表面側からその端子を挿通させ、前記主制御基板の裏面側でその端子が半田付けされる複数のディップ実装部品と、が実装され、

前記表面実装部品として、第１の部品と、第２の部品を少なくとも含み、

前記第１の部品及び前記第２の部品はそれぞれ複数の端子を有しており、前記第１の部品の複数の端子と前記第２の部品の複数の端子との間がそれぞれ配線で接続され、

前記第１の部品の複数の端子と前記第２の部品の複数の端子との間を接続する配線のそれぞれに対してテストポイントが設けられており、

前記主制御基板の前記表面実装部品の実装面に対して反対側となる面には前記テストポイントが設けられず、

前記配線のそれぞれに対して接続されたテストポイント同士の間隔は、前記複数の端子の間を接続する配線同士の間隔のうち最も狭い部分の間隔よりも広いものであり、

前記テストポイントは、前記主制御基板に設けられ前記ディップ実装部品が実装されない貫通孔であるビアホール

のサイズと異なるサイズを有することを特徴とする遊技機。

10

20

30

40

50